

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務 — 我們的策略」一節。

### [編纂]用途

假設[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]及其他估計[編纂]，並假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，我們估計將自[編纂]收取[編纂]約[編纂]百萬港元。我們擬將[編纂][編纂]用於加強我們的研發能力、擴大我們的整體產能、進行策略性投資及／或收購、擴大我們的全球銷售業務及海外銷售與服務網絡，以及用作營運資金及其他一般企業用途，詳情載列如下。

下表載列各主要類別[編纂]用途按年劃分的預期實施時間表：

### [編纂]

約[編纂]%的[編纂]淨額或[編纂]百萬港元將用於加強我們的研發能力，此乃我們長期創新策略的核心。於往績記錄期間，我們的研發開支佔收益的百分比保持穩定，表明我們致力於創新，而未對盈利能力造成重大影響。我們的直寫光刻設備需要光學、機械、電子、計算及軟件的綜合專業知識，而持續投資人才與技術對系統化升級及維持競爭優勢至關重要。該等投資將有助於產品升級以實現更高的光刻精度、開發高效緊湊的設備以滿足客戶需求，以及及早部署符合行業趨勢的下一代產品。我們計劃在直寫光刻技術方面取得突破性進展、招募及留聘頂尖研發人才，以及優化及在國內生產關鍵部件。我們旨在加速產品開發、拓展新興應用領域，利用AI技術並建立一個可擴展的平台式技術基礎，以支持可持續增長及全球擴張。儘管增加的研發成本或會於短期內影響我們的整體財務表現，但預期該等舉措

## 未來計劃及[編纂]用途

將透過實現產品差異化、提升我們產品的利潤率及鞏固我們在先進光刻技術方面的領導地位來改善我們的業務營運。

- 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用於研發製造設備，以用於更先進的高端印刷電路板及先進封裝、IC載板等半導體細分領域產品的製造工藝，並特別專注於高解像度、高精度及高效率的直寫光刻技術。我們亦擬探索及孵化直寫光刻技術於新興行業的新應用。
- 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用於建立及加強我們的國內外研發人才團隊。我們計劃在核心技術領域招募頂尖專家，並與海外人才建立長期合作夥伴關係，以確保與我們的長期增長策略一致。我們擬於中國及海外招聘約30至40名研發人員，其年度薪酬範圍介乎人民幣800,000元至人民幣3.0百萬元。彼等的主要職責將包括產品設計與開發、技術研究與創新。候選人預期持有相關領域的學士或以上學位，並於直寫光刻設備行業擁有至少八年的行業經驗。此外，我們計劃招聘約22至30名在中國生產部門的生產專家，年薪範圍為人民幣140,000元至人民幣200,000元；約五至八名在國內外市場銷售中心的銷售專才，年薪範圍為人民幣600,000元至人民幣1,800,000元；及約八至十五名在國內外職能部門的營運及管理人員，年薪範圍為人民幣180,000元至人民幣300,000元。
- 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用於優化及在國內生產關鍵部件。具體而言，我們將推進光源系統及精密運動平台等關鍵子系統的開發和升級，旨在減少對供應鏈的依賴並開發國產替代品。我們亦計劃將人工智能算法整合到我們的設備系統中，以實現系統參數的實時優化、預測性維護及智能故障檢測。透過使用人工智能，我們旨在解決對準速度、基板翹曲及RDL錯位等關鍵問題，此舉將有助於提高生產良率。人工智能賦能的預測性維護及智能故障診斷亦將提升設備效率並縮短維修時間，確保我們客戶的生產線平穩可靠地運行。這將支持開發可擴展的平台式技術架構，該架構能適應多樣化的應用場景並加速產品創新。

約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用於擴大我們的整體產能。我們計劃策略性投資於我們在東南亞的主要設施，並透過數碼化轉型及AI升級我們的生產基礎設施。我們相信該等擴展及提升將提升我們的專業知識及能力，有助於我們提高產品質量，並加強我們滿足全球日益增長的客戶需求的能力。

- 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用於擴大我們在泰國的產能。東南亞憑藉其地理優勢、充裕的勞動力供應及具成本效益的製造環境，已成為全球電子產業的

## 未來計劃及[編纂]用途

主要樞紐。根據中國印製電路行業協會(CPCA)的資料，全球前40大PCB製造商中，超過30家已宣佈計劃於2026年前在泰國、越南或馬來西亞建立生產基地。泰國投資促進委員會(BOI)報告稱，PCB行業的核准投資額從2020年的約人民幣815.3百萬元增長至2024年的人民幣13,745.1百萬元，複合年增長率為102.6%。根據灼識諮詢的資料，泰國的PCB產值將從2024年的約人民幣250億元增長至2030年的人民幣401億元，複合年增長率約為8.0%，超過同期全球增長率。我們認為，強勁的行業增長及客戶需求為我們在泰國的產能擴張計劃提供了支持。

為更好地支持海外訂單的交付、及時服務人工智能及汽車電子等快速增長領域的客戶並加強我們的區域製造佈局，我們計劃透過於泰國收購土地、建造新廠房及採購生產設備與配套設施，提升我們附屬公司的生產能力。這次擴建將新增一條新生產線，專門用於擴大我們現有PCB產品的產能，預計可增加50至100台的產能，預期產能利用率約為80%至90%。計劃分配包括[編纂]百萬港元用於土地成本，[編纂]百萬港元用於收購廠房，[編纂]百萬港元用於翻新工程，[編纂]百萬港元用於設備採購及數字化升級，[編纂]百萬港元用於輔助工具，及[編纂]百萬港元用於日常營運開支(包括工資、中介費用及營運資金)。

- 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用於對我們的生產線進行數碼化升級及整合人工智能。我們旨在建立一個全面整合的設備製造環境，以實現端到端的生產可視化及流程優化，此舉將有助於我們提高生產效率並加強可追溯性及質量控制。該等升級預期將使勞動力需求減少約20%，整體工作效率提高約10%(按每台平均整合及調試時間的減少計量)，並透過加強管理及預測性維護將設備故障率降低約30%。

約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用於策略性投資及／或收購，旨在加強我們在整個行業價值鏈中的地位。我們計劃尋求橫向及縱向擴張機會，以提升我們的技術能力、確保關鍵上游資源，並推動長期可持續增長。截至最後實際可行日期，我們尚未物色到任何收購目標。

- 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用於對行業價值鏈內的設備公司進行策略性投資或收購。透過物色及投資或收購擁有先進核心技術及關鍵人才的早期或成長期公司，我們旨在透過公平合作實現協同技術整合，並提升我們的整體技術能力。在選擇潛在收購目標時，我們將考慮以下因素：(i)擁有與我們現有具協同效應並能提升我們技術競爭力的專有或先進核心技術；(ii)擁有強大的技術人員團隊，尤其是具備設備設計、系統集成及創新管理方面專業知識的人員；(iii)擁有約至少五年的經營歷史；(iv)自成立以來擁有良好的合規記錄，無重大違反適用法律法規

## 未來計劃及[編纂]用途

的行為；及(v)擁有透明的股權結構，無重大訴訟、仲裁或所有權糾紛，並已具備合法經營所需的一切必要執照、許可及批准。此外，我們的收購策略擬定的時間框架為2026年至2029年，重點為收購目標公司的多數股權。就設備製造商而言，我們預計將以一至兩家公司為目標，其年銷售額最高可達人民幣100.0百萬元，主要從事激光加工及光學檢測設備業務。就關鍵組件製造商(包括鏡頭、激光器、核心控制系統及光學模塊)而言，我們將優先考慮年收益超過人民幣30.0百萬元。組件製造商目標的數目將不受限制。地域範圍將為全球性，惟不包括受國際制裁或貿易限制的司法管轄區。我們亦將優先考慮具備可擴展基礎設施、強大市場相關性，且有潛力透過協作整合及技術協同效應為我們的長期戰略目標作出重大貢獻的公司。根據灼識諮詢的資料，市場上有充足符合本集團標準的收購目標。因此，本公司董事相信，市場上有符合本公司甄選標準的收購目標，且本公司的收購計劃屬切實可行。

- 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用於縱向整合，即收購LDI設備價值鏈中的上游關鍵部件供應商。透過該等收購，我們擬加強供應鏈的穩定性並提高關鍵原材料的可互換性。

約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用於擴大我們的全球銷售業務及發展我們的海外銷售與服務網絡。

- 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用於建立海外技術服務中心。我們計劃在主要國際市場設立多個服務中心，配備專業的售後工程師並具備全面的維護能力。該等中心將使我們能夠提供及時、優質的設備維保及技術支持，從而提高客戶滿意度及運營可靠性。下表載列我們計劃設立的海外技術服務中心的概覽，包括主要實施詳情：

地點	實施時間	擬招聘員		初始投資 (人民幣千元)	年度營運	預計三年收益貢
		工人數	薪金範圍 (人民幣/年)		成本 (人民幣千元)	獻 (人民幣千元)
中國台灣 .....	於2027年底前	12	300,000-600,000	2,000	10,500	64,800
馬來西亞 .....	於2028年底前	8	250,000-500,000	1,500	7,000	43,200
越南.....	於2027年底前	10	250,000-500,000	1,500	8,750	54,000
日本.....	於2027年底前	6	400,000-700,000	2,000	5,250	32,400
韓國.....	於2027年底前	5	400,000-700,000	2,000	4,400	27,000

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

- 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用於建立及擴展我們的海外銷售網絡。我們擬在歐洲、美國、東南亞、日本、韓國及中國台灣等戰略地區部署專職銷售團隊。該等團隊將專注於推廣我們的產品組合、深化市場滲透，並提升品牌知名度及市場份額。
- 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用於品牌建設及渠道營銷活動。我們將參加全球領先的半導體展覽會(如SEMICON)、在行業媒體上開展定向廣告活動，並執行整合營銷計劃，以提升我們在海外市場的品牌知名度及影響力。

約[編纂]%的[編纂]或[編纂]百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]定為指示性[編纂]範圍之最高[編纂]或最低[編纂]，則[編纂][編纂]將分別增加或減少約[編纂]百萬港元。倘[編纂]的[編纂] (包括因行使[編纂][編纂]) 多於或少於預期，我們將按比例調整上述用途的[編纂]分配。

倘[編纂][編纂]並無即時用作上述用途，或倘我們未能按計劃實行任何未來發展計劃，只要被視為符合本公司的最佳利益，我們可將該等資金存入持牌商業銀行及／或其他認可財務機構(定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律及法規)的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則下的適當披露規定。